



# 鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

## HTG-200D 常规系列

### 【双组份导热凝胶】规格书



-产品图-

#### 应用特点：

- $\geq 2.0\text{W/m.K}$  导热系数
- 以不定形状替代传统的组装式片材
- 可通过各种手工或自动化的工艺进行点胶
- 柔软，可消除装配应力，减震阻尼
- 固化后可保持所需厚度

#### 应用领域推荐：

- 半导体块和散热器
- 用于LED灯具和发光体、汽车和消费领域
- 点胶或直接涂覆成各种厚度和形状
- 高性能中央处理器及显示卡处理器

#### 应用方式：

双组份导热凝胶可通过各种方式使用，包括：自动点胶、手动涂覆。

#### 包装：

根据不同需求，可以按照400cc双管或20L桶装等容量，按照1：1的方式灌注包装。

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

#### 储存条件：

- 阴暗处储存，
- 储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$ ；
- 储存湿度： $\leq 70\%$ ；

#### 保质期：

- 在储存条件下：半年
- 不符合储存条件下：三个月

#### 产品性能

NO.	参 数	单 位	测试方法
颜色	A组分	白 色	--
	B组分	灰 色	--
	混合后	灰白色	--
状 态	高粘度流体	--	--
密 度	$\leq 2.5$	g/cc	ASTM D 792
混合比例	1:1	--	质量比
固化条件	表面固化 @25°C	1	H
	完全固化 @25°C	24	H
	加速固化 @100°C	15	min

#### 硫化后

导热系数	$\geq 2.0$	W/m·K	ASTM D 5470
热 阻	$\leq 1.0$ (@20psi&1mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470
硬 度	55( $\pm 10$ )	Shore 00	ASTM D 2240
击穿电压	$\geq 10$	kV /mm	ASTM D 149
体积电阻率	$\geq 10^{12}$	$\Omega.\text{cm}$	ASTM D 257
压缩比	$\geq 20$ (@50psi)	%	ASTM D 695
拉伸强度	$\geq 0.1$	MPa	ASTM D 412
延伸率	$\geq 100$	%	ASTM D 412
粘接强度	$\geq 0.05$	MPa	ASTM D 624
出油率	$\leq 1$	%	ASTM G 120
撕裂强度	$\geq 0.6$	KN/m	ASTM D 624
介电常数	$\geq 2$	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	$\leq 0.1$	@1MHz	ASTM D 150
防火性能	V0	--	UL 94
使用温度	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权